

美商高通公司對國內手機製造商及晶片供應商作出行為承諾，並負有向公平會報告執行情形之義務：

一、本於善意重新協商授權條款：

臺灣手機授權製造商如認為其與美商高通公司之專利授權合約中有被迫同意且不合理之授權條款，美商高通公司承諾將本於善意重新協商，就重新協商條款之爭議，臺灣手機授權製造商與美商高通公司可另行協議採取其他如法院或仲裁之中立爭端解決程序。

二、協商期間不拒絕晶片供應：

在重新協商或爭端解決程序期間，臺灣手機授權製造商如繼續履行其供應及授權合約義務，並本於善意進行重新協商，美商高通公司同意其不會終止或威脅終止供應行動數據機晶片予該製造商。

三、行動通訊 SEP 授權之無歧視性待遇：

美商高通公司承諾就其行動通訊 SEP 授權方案，將對條件相當之臺灣手機製造商與非臺灣手機製造商給予無歧視之待遇。

四、對臺灣晶片供應商之待遇：

美商高通公司同意，經臺灣晶片供應商要求，其將提供一合約。該合約約定，如美商高通公司未先就行動通訊 SEP 請求項向晶片供應商提出依公平、合理且無歧視（FRAND）之授權條款，美商高通公司不得本於任何行動通訊 SEP 請求項對該晶片供應商提起任何訴訟。

五、不再簽署獨家交易之折讓約定：

美商高通公司承諾，在其與晶片客戶之晶片供應合約中，不再簽署任何以客戶同意獨家採用美商高通公司行動數據機晶片為條件，而給予權利金折讓之約定；及不

再以該晶片客戶之全部晶片採購有一定比率係向美商高通公司採購，作為契約之授權金折扣或權利金折讓約定之條件。

六、定期向公平會報告執行情形：

美商高通公司並承諾在 5 年期間內，每 6 個月就行為承諾之執行情形向公平會進行報告，如美商高通公司與臺灣手機製造商或臺灣晶片供應商完成增修或新訂契約，亦將於簽署該等契約後 30 日內向公平會進行報告。